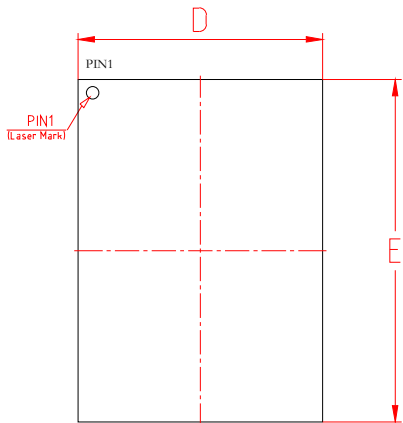


ROHS

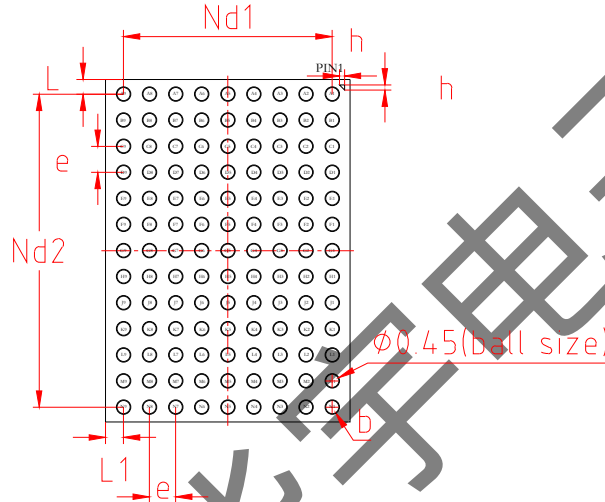
TOP VIEW  
正视图



SIDE VIEW  
侧视图



BOTTOM VIEW  
背视图

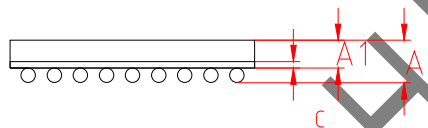



机械尺寸/mm			
字符 SYMBOL	最小值 MIN	典型值 NOMINAL	最大值 MAX
A	1.200	1.300	1.300
A1	0.820	0.850	0.880
c	0.170	0.200	0.230
D	7.400	7.500	7.600
b	φ0.400 BSC		
Nd1	6.400 BSC		
Nd2	9.600 BSC		
e	0.800 BSC		
L	0.450 BSC		
L1	0.550 BSC		
h	0.150 BSC		
E	10.400	10.500	10.600

BALL MAP (TOP VIEW)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	01_48	01_47	01_18	01_50	01_20	01_52	01_22	01_53	01_54
B	01_16	01_4748	01_17	01_49	01_19	01_51	01_21	01_5354	01_24
C	01_15	01_1516	01_1718	01_4950	01_1920	01_5152	01_2122	01_2324	01_23
D	01_46	01_45	01_4546	CLK_I	CLK_O	VPP	01_5556	01_55	01_56
E	01_14	01_13	01_1314	MDSI	MISO	TM	01_2526	01_25	01_26
F	01_44	01_44	01_12	01_12	CS	VDD	01_5758	01_57	01_58
G	01_43	01_43	01_11	01_11	VCC	VSS	01_2728	01_27	01_28
H	01_42	01_42	01_10	01_10	OPT_EN	VDDN	01_5960	01_59	01_60
J	01_41	01_41	01_09	01_09	OPT_BGR	01_6162	01_2930	01_29	01_30
K	01_40	01_39	01_3940	01_04	01_03	01_02	01_01	01_61	01_62
L	01_08	01_07	01_0708	01_04	01_03	01_02	01_01	01_3132	01_31
M	01_37	01_3738	01_0506	01_36	01_35	01_34	01_33	01_6364	01_32
N	01_38	01_05	01_06	01_36	01_35	01_34	01_33	01_64	01_63

SIDE VIEW  
侧视图



 <b>池州华宇电子科技股份有限公司</b> CHI ZHOU HISEMI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD				制图: Draw	NINGLIN 2024. 9. 5
HY-POD-LGA0025				制图核查: Drawing review	
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS BGA117 (7.5×10.5×1.3-P0.8)				审核: Checker	
页数 page	单位 unit	比例 scale	视图 view	核准: Approved	
	mm	1:1	